

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成 28 年 7 月 21 日 (2016.7.21)

【公開番号】特開 2014-4681 (P2014-4681A)

【公開日】平成 26 年 1 月 16 日 (2014.1.16)

【年通号数】公開・登録公報 2014-002

【出願番号】特願 2013-129309 (P2013-129309)

【国際特許分類】

B 8 1 B 7/02 (2006.01)

H 0 1 L 29/84 (2006.01)

G 0 1 P 15/08 (2006.01)

【F I】

B 8 1 B 7/02

H 0 1 L 29/84 Z

H 0 1 L 29/84 A

G 0 1 P 15/08 P

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 6 月 2 日 (2016.6.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

センサ、および

接合部分

を備える M E M S ダイと、

アイソレーション装置と

を備える微小電子機械システム ( M E M S ) パッケージであって、前記アイソレーション装置が、

前記 M E M S ダイの前記接合部分に接合されるように構成され、前記 M E M S ダイの前記接合部分の熱膨張率にほぼ等しい熱膨張率を有する第 1 の層と、

モノリシック材料で形成されたばね層と

を備え、前記ばね層が、

前記第 1 の層に接合するように構成された第 1 の区間と、

回路板に接合するように構成された第 2 の区間と、

前記第 1 の区間を前記第 2 の区間に柔軟に取り付けられるように構成された 1 つまたは複数のばね要素と

を備える、M E M S パッケージ。

【請求項 2】

前記第 1 の層が、前記 M E M S ダイが前記第 1 の層に実装されたとき M E M S ダイが通過することを可能にするように構成された空洞を備え、前記空洞が、前記 M E M S ダイだけに接合されるように構成された少なくとも 1 つのフランジを備え、前記第 1 の層または前記ばね層のうちの少なくとも 1 つが、前記少なくとも 1 つのフランジを前記ばね層から分離するように構成された凹部を備える、請求項 1 に記載のパッケージ。

【請求項 3】

前記ばね層がシリコンを含み、前記第 1 の層がガラスを含む、請求項 1 に記載のパッケージ。

ー ジ。